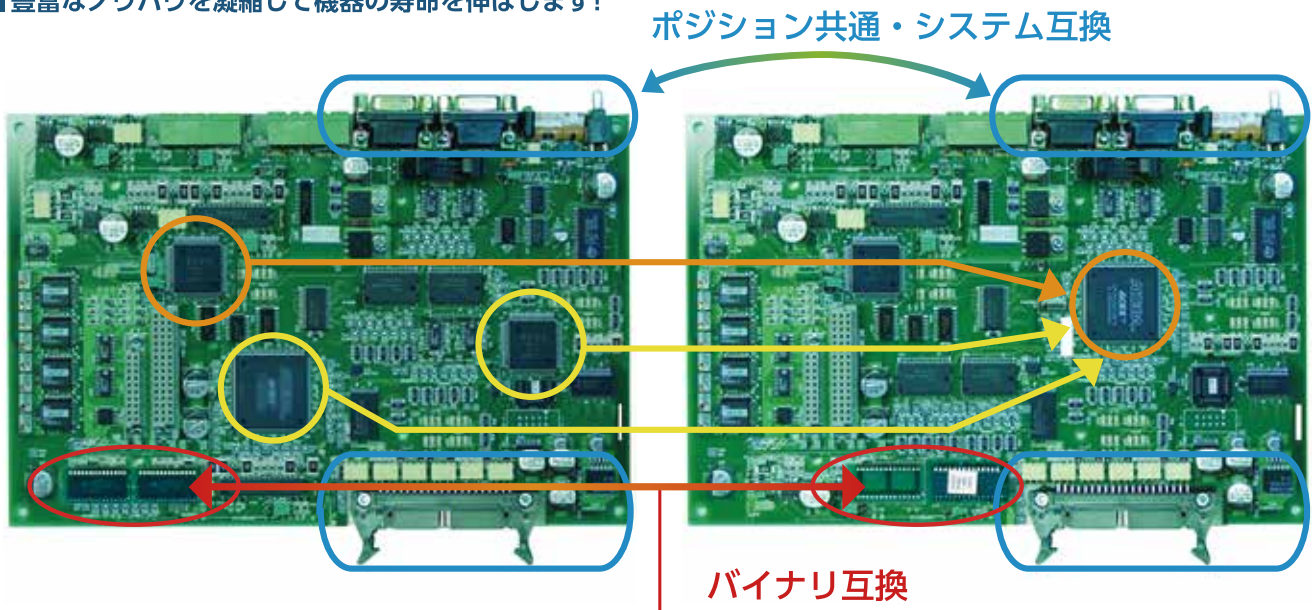


生産中止デバイスを FPGA へリプレース

生産中止になった ASSP、ASIC を FPGA にリプレースし製品寿命の延命を実現しました。

■豊富なノウハウを凝縮して機器の寿命を伸ばします!



開発内容

- ▶ 生産中止になったデバイスのデータシートを元にした内部回路の生成
- ▶ 現基板への実装方法、デバイス選定や電源供給及びトレラントの考慮
- ▶ 現基板にて動作させ、従来品と同じ動作が可能

特徴

- ▶ DIP 品の場合は、ピンアサイン、フットパターン互換で実現することで基板の改版不要で寿命を延命
- ▶ 生産中止品のレジスタ、機能を忠実に再現することで既存のソフトを一切変更することなくリプレースが可能
- ▶ 未使用機能を実装しないことで FPGA の容量などを削減し、生産中止になっていない部品も合わせて取り込むことで基板のコストダウンを図る